

Einseitig

Doppelseitig

Multilayer

Flex

Starr-Flex

Bohrungen & Vias

Verhältnis Bohrlochtiefe zu min. Bohrdurchmesser	12:1
Min. Enddurchmesser	0,1 mm
Sackloch – min. Enddurchmesser	0,2 mm
Sackloch – min. Außenlage Paddurchmesser	0,35 mm
Sackloch – min. Innenlage Paddurchmesser	0,35 mm
Sackloch – Aspect Ratio	1:1

Außenlagen

Min. Leiterbahnbreite	0,08 mm
Min. Leiterbahnabstand	0,08 mm
Min. Paddurchmesser	0,35 mm

Innenlagen

Min. Leiterbahnbreite	0,08 mm
Min. Leiterbahnabstand	0,08 mm
Min. Paddurchmesser	0,35 mm

SMD & Komponenten

Min. SMD-Pad	0,2 mm
Min. Bauteilabstand	0,37 mm

Materialstärken

Max. LP-Endstärke	3,5 mm
Min. LP-Endstärke	0,1 mm
Max. Kupferschichtstärke	235 µm
Min. Kupferschichtstärke	9 µm
Min. Lagenabstand	0,05 mm

Größen

Max. Leiterplattengröße – doppelseitig	490 × 580 mm
Max. Leiterplattengröße – Multilayer	405 × 535 mm

Fräsen & Toleranzen

Min. Innenradius	0,25 mm
Frästoleranz	±0,10 mm
Ritztechnik – min. Materialstärke	0,5 mm
Toleranz DK-Durchmesser	+0,10 / -0,05 mm
Toleranz Bohrposition	±0,05 mm
Toleranz Basismaterialstärke	±10 %

Einseitig

Doppelseitig

Multilayer

Flex

Starr-Flex

Lackfreistellung

Abziehlack – min. Überdeckung **0,3 mm**Abziehlack – min. Freistellung **0,6 mm**Lötstopmmaske – min. Freistellung **0,05 mm**

Lötstopmmaske

☒ Grün☐ Rot☐ Weiß☐ Schwarz☐ Blau

(Lackwerke Peters)

Spezialdruck

☐ Abziehlack – RoHS-kompatibel☐ Carbondruck

Oberflächenveredelung

☐ HAL / HAL bleifrei☐ Chem. Ni/Pd/Au (ENIG)☐ Chem. Ni/Au (ENIG)☐ Galvanisch Ni/Au☐ Chem. Sn☐ OSP

Basismaterialien

☐ Alle FR4*☐ Polyimid**☐ Rogers**☐ Aluminium (Cu-kaschiert)**

* Bei UL-gekennzeichneten Leiterplatten eingeschränkte FR4-Basismaterialien und Lötstopplacke

** Ohne UL-Kennzeichnung

Zertifizierungen

DIN EN ISO 9001:2015

UL-Zertifizierung (US und C) für ZPVM2 und ZPVM8

E-File: E119015

ZPVM8 wird durch CSA anerkannt